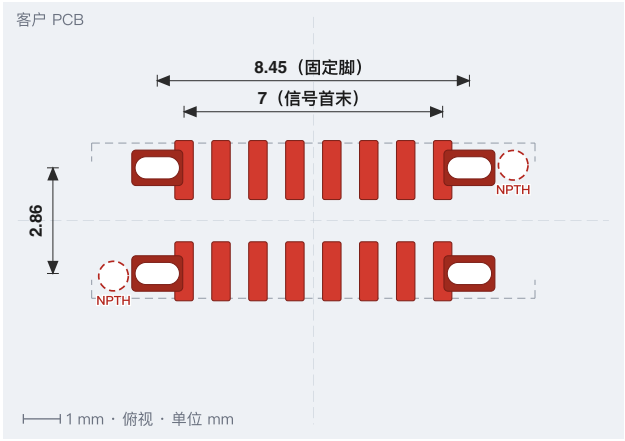
料号 PART NO.	封装 FOOTPRINT	类型 TYPE
CF16V-4DSYA3S9-150S3N31	CF16V-4DSYA3S9-150S3N31	立式 / 16P



灰底 = PCB / 红 = 焊盘 / 白孔 = PTH 金属化槽孔 / 红虚线圈 = NPTH 非金属化孔（不焊锡） / 灰虚线 = 元件外形（示意）

关键尺寸

项目	数值 (mm)
信号焊盘 16 个	16×0.5×1.597
针距 / 首末距	1 / 7
两排行距	2.74
固定脚焊盘 4 个	4×1.38×0.96
固定脚 槽孔（金属化）	4×1.2×0.6
固定脚间距	8.45 × 2.86
定位柱孔	Ø0.8 × 2
焊盘层	Top（SMD）
三类孔	SMD 16 / PTH 4 / NPTH 2

安装要点

- **立式与 PCB 是完全插入关系**：外壳靠近开口那一圈没有固定脚 / 卡爪，只有下方与板连接处有焊脚；外壳底面直接贴合板面，焊脚埋进板内、外部看不到金色端子。
- **孔型按本款封装，别按族名猜**：信号盘 16×0.5×1.597（SMD 贴片、仅顶层无孔）、固定脚盘 4×1.38×0.96 + 孔 4×1.2×0.6。立式既有插板款也有全贴片款，一律以关键尺寸表与交付 PcbLib 为准。
- **三类孔**：**SMD 贴片焊盘**：仅顶层、无孔，SMT 回流焊；**PTH 金属化槽 / 孔**：孔壁镀铜、可插件焊接导通；**NPTH 非金属化孔**：钻孔打通、无铜，只给塑胶柱避位定位、不焊锡。
  本封装含 **2 个 NPTH 非金属化孔。嘉立创 EDA 请用「非金属化孔」图元，不勾多层 / 金属化**、勿做成焊盘孔，否则板厂会按 PTH 镀铜。

常见问题

你会看到	实情
定位柱孔要电镀 / 上锡吗？嘉立创 EDA 怎么做？	**不要**。NPTH 钻孔打通、无铜，只给塑胶柱避位定位、不焊锡。**嘉立创 EDA 请用「非金属化孔」图元**，不勾多层 / 金属化、勿做成焊盘孔，否则板厂会按 PTH 镀铜。
开口那一圈怎么没有卡爪	正常。立式外壳靠近端口处是光洁的，固定脚只在下方与板连接处。
灰虚线是丝印吗	**不是**。灰虚线是**元件外形**示意，用来看这个料占多大板面；封装里真正的丝印（Top Overlay）在固定脚处**断开**，以交付 PcbLib 为准。
固定脚只焊一侧行吗	**不行**。固定脚与外壳同网，须全部焊通以保证抗剥离。
SchLib 放置后要手动指定封装吗	要。符号库不预挂封装，请在属性里选 **CF16V-4DSYA3S9-150S3N31**。
3D 预览里看不到孔	正常。3D 只显示产品本体，孔位与孔径以 2D 封装（PcbLib）与随附 PDF 图纸为准。

尺寸取自随附 PDF 图纸的 **RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT** 视图，并逐项与交付件 **CF16V-4DSYA3S9-150S3N31.PcbLib** 核对：信号盘 16×0.5×1.597、针距 1、首末中心距 7、固定脚中心距 8.45×2.86、三类孔 SMD 16 / PTH 4 / NPTH 2。